

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年 10 月 16 日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2025-024

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国投瑞银基金；国信证券；国投证券；东证融汇证券资产管理有限公司。
时间	2025 年 10 月 16 日
地点	现场交流
上市公司参加人员姓名	董事会秘书：龚小刚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司汽车电子芯片业务的最新市场进展怎么样，该业务的驱动力和前景如何，公司汽车电子芯片业务的优势、发展方向有哪些，请简要谈谈？</p> <p>答：目前，公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、小鹏、理想、赛力斯、广汽等众多汽车整机厂商，实现批量应用。公司与埃泰克、经纬恒润、科世达（上海）、弗迪科技、弗迪动力、弗迪电池、长江汽车电子、欧菲智能、易鼎丰、英创汇智、安波福、松原安全、法雷奥等国际国内 Tier1 模组厂商保持紧密合作，同时与潍柴动力、奥易克斯、武汉菱电、常州易控、凯晟动力等多家发动机及模组厂商保持业务协同创新与合作。公司与经纬恒润、东软睿驰、普华软件等携手正式推出完整的 Classic Platform</p>

(CP) AUTOSAR 解决方案，加速助推“中国芯+中国软件”车用底层解决方案应用落地，获得了市场的认可和良好的业界口碑。截至 2025 年 6 月 30 日，公司汽车电子芯片已累计出货超过 1700 万颗。2025 年上半年公司实现汽车电子芯片业务收入 4,915.36 万元，同比增长 63.81%。三季度以来，公司持续推进汽车电子芯片产品的定点应用开发和量产，目前公司汽车电子芯片项目的应用开发验证工作和量产供货在紧锣密鼓推进。

目前，汽车电子芯片国产替代的整体趋势未发生变化，汽车产业向电动化、智能化和网联化的转变愈发强烈，未来新能源车对于芯片的需要会更加旺盛，从而推动了汽车电子芯片更多的国产化应用，公司积极顺利这一趋势，积极深耕汽车电子 MCU 芯片、汽车电子数模混合芯片和 DSP 芯片业务。在实现汽车域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用 DSP 芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等 12 条产品线系列化布局的基础上，公司坚持“顶天立地”、“铺天盖地”战略与“MCU+”策略不动摇，继续深耕深挖技术、加高加固护城河、拓宽拓广项目资源。公司重点发展的系列化汽车电子芯片产品逐步规模化上车应用，特别是安全气囊芯片、车身与网关芯片、车联网安全芯片、域控芯片、DSP 芯片、动力总成芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片等产品线已实现规模化量产供货，在国产汽车电子芯片领域打开良好局面，特别是在比亚迪、奇瑞等头部车企大客户中取得较为重要的进展，未来有望实现更多中高端汽车电子芯片产品在更多客户量产供货。

随着新能源汽车智能化进程加快，传统 12V 低压系统已难以满足新一代智能功能的功率需求。48V 系统以其更高的功率承载、更优的能效表现和更强的功能安全保障，成为汽车电气架构升级的关键路径。公司积极应对这一发展趋势，尝试构建 48V 混合信号芯片设计平台，CCL1800B 是面向 48V 架构的首款安全气囊点火芯片，实现业界首发，作为 48V 安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白，实现了新能源汽车安全气囊点火应用电子电气系统架构领域的创新与突破。以该芯片为基础，公司搭建 48V 混

	<p>合信号芯片设计平台，平台化布局初步成型并支撑后续多应用领域扩展。</p> <p>公司汽车电子芯片积极拥抱 RISC-V+AI，国芯科技高性能汽车智能域控 AI MCU 芯片 CCFC3009PT 完成设计进入流片试制阶段。作为国芯科技深耕汽车电子领域多年的标志性成果，CCFC3009PT 采用 RISC-V 架构 6+6 核设计，算力超过 10000DMIPS（6 个运算主核+6 个锁步核，也可以根据用户需要解耦配置主核与锁步核数量），集成专用 NPU 单元，完全依照汽车智能域控场景的需求量身打造。在工艺层面，该芯片创新性地采用 22nm RRAM 存储技术，相较于传统存储方案，该工艺技术实现了存储密度、读写速度与功耗控制的三重优化；同时针对动力域控制场景系统架构完成算法执行效率升级，能够充分适配集成化多模动力域控、智能底盘、域控中枢等核心场景的高性能与智能化运行需求。AI 能力的深度植入，是这款芯片的核心亮点所在。该芯片内部搭载独立 NPU 子系统，可以将虚拟传感器、模型预测通过“硬件加速+工具链适配”的深度整合方案，让开发者可直接沿用成熟的端侧 AI 开发逻辑开展应用设计，大幅降低了车载 AI 功能的开发门槛。更值得关注的是，在 CCFC3009PT 的设计中，国芯科技将 NPU 单元与 RRAM 工艺创新结合，在此基础上将进一步探索存算一体等前沿技术，可为未来更高阶的车载 AI 任务落地储备关键技术，是国产汽车电子 MCU 芯片往高端化、智能化方向发展的跨越。</p> <p>同时，公司始终以技术与产品为根基，狠抓汽车电子芯片产品质量，以市场为抓手与导向，持续加强品牌建设，公司建有一支年富力强的汽车电子芯片技术支持服务工作团队，能够及时为客户提供全面、专业的技术支持服务，进一步促进了汽车电子芯片的应用和量产，努力保障汽车电子业务健康发展。</p> <p>说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。</p>
附件清	无

单（如有）	
日期	2025年10月